

	登録番号 (公開番号)	外国出願 Patent No.	発明の名称 Title of Invention	明細書 Description
メッキ接合 Plating Bonding	特許第6551909号 (2019/07/12)	US.9601448.B2 (2017/3/21)	電極接続方法及び電極接続構造 ELECTRODE CONNECTION STRUCTURE AND ELECTRODE CONNECTION METHOD	JP 006551909 US9601448B2
	特許第6667765号 (2020/02/28)	US.9601448.B2 (2017/3/21)	電極接続方法及び電極接続構造 ELECTRODE CONNECTION STRUCTURE AND ELECTRODE CONNECTION METHOD	JP 006667765 US9621448B2
	特許第7046368号 (2022/03/25)	US.10903146.B2 (2021/1/26) DE11017001206B4 (2023/12/7)	電極接続構造、リードフレーム電極接続構造の形成方法 ELECTRODE CONNECTION STRUCTURE, LEAD FRAME, AND METHOD FOR FORMING ELECTRODE CONNECTION STRUCTURE	JP 007046368 US10903146B2 DE112017001206B4
	特許第7178713号 (2022/11/17)	US11152286B2 (2021/10/19)	パワー半導体モジュール装置及びパワー半導体モジュール製造方法 POWER SEMICONDUCTOR MODULE DEVICE	JP 007178713 US11152286B2
	特開2024-33469 (2024/3/13)		半導体装置及び接合方法 (Fe-Ni) SEMICONDUCTOR DEVICE AND BONDING METHOD	JP 2024033469 (公開)
Niナノ粒子 Ni- nanoparticles	特許第6061427号 (2016/12/22)		電子部品の接合材、接合用組成物、接合方法、及び電子部品 ELECTRONIC COMPONENT BONDING MATERIAL, COMPOSITION FOR BONDING, BONDING METHOD,AND ELECTRONIC COMPONENT	JP 006061427
	特許第6384894号 (2018/08/17)	TWI624356 (B) (2015-08-01) US.9960140 B2 (2018/5/1)	金属ナノ粒子を用いた金属接合構造及び金属接合方法並びに金属接合材料 METAL JOINING STRUCTURE USING METAL NANOPARTICLES AND METAL JOINING METHOD AND METAL JOINING MATERIAL	JP 006384894 US9960140B2
	特許第6384895号 (2018/08/17)	TWI624356 (B) (2015-08-01) US.9960140 B2 (2018/5/1)	金属ナノ粒子を用いた金属接合構造及び金属接合方法 METAL JOINING STRUCTURE USING METAL NANOPARTICLES AND METAL JOINING METHOD AND METAL JOINING MATERIAL	JP 006384895 US9960140B2
	特許第7198479号 (2022/12/21)	US11810885 (2023/11/07)	半導体素子接合構造、半導体素子接合構造の生成方法及び導電性接合剤 SEMICONDUCTOR ELEMENT BONDING STRUCTURE, METHOD FOR PRODUCING SEMICONDUCTOR ELEMENT BONDING STRUCTURE,	JP 007198479 US11810885B2
ボンディング ワイヤ BondingWire	特許第5728126号 (2015/04/10)	US9059003 B2 (2015/6/16)	パワー半導体装置及びその製造方法並びにボンディングワイヤPOWER SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD OF MANUFACTURING THE DEVICE AND BONDING WIRE	JP 005728126 US9059003B2
スラッジ回収 Sludge Recovery	特許第6251870号 (2017/12/08)		スラッジ回収方法及び粉粒体の製造方法 SLUDGE RECOVERY METHOD AND GRANULAR MATERIAL	JP 006251870
ワイヤボン ディング Wire Bonding	特許第5804644号 (2015/09/11)		超音波ワイヤボンディング装置および超音波ワイヤボンディング方法	JP 005804644
構造体接合	特開2022-133193 (2022/09/13)		接合構造体及びその製造方法 JOINING STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD FOR SAME	JP 2022133193 (公開)
機能性シート	特開2023-124553 (2023/9/6)		放熱シート及び放熱シートの製造方法	JP 2023124553 (公開)